

日月光一〇〇年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 100 年 10 月 28 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇〇年度第三季及前三季獲利報告，本公司一〇〇年第三季之合併營業收入較一〇〇年第二季成長 1%，較九十九年同期衰退 9%，為新台幣 46,698 百萬元。茲將日月光一〇〇年度第三季單季及前三季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	100 年度 第三季	100 年度 第二季	99 年度 第三季	100 年度 前三季	99 年度 前三季
營業收入	46,698	46,254	51,489	138,957	135,460
營業毛利	8,912	8,964	11,105	26,534	28,577
營業淨利(淨損)	4,312	4,621	6,665	13,320	16,707
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,200	4,749	6,475	14,045	15,932
所得稅利益(費用)	(717)	(998)	(771)	(2,678)	(1,838)
少數股權純損(益)	(15)	(107)	(244)	(281)	(626)
本期淨利(淨損)	3,468	3,644	5,460	11,086	13,468
稀釋每股盈餘(元)	0.52	0.54	0.81	1.63	2.01

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	100 年度 第三季	100 年度 第二季	99 年度 第三季	100 年度 前三季	99 年度 前三季
營業收入	32,581	32,255	34,015	95,715	93,135
營業毛利	7,319	7,533	9,103	21,948	23,853
營業淨利(淨損)	3,866	4,334	5,890	12,172	15,075
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,004	4,580	6,211	13,360	15,319
所得稅利益(費用)	(523)	(832)	(596)	(2,001)	(1,517)
少數股權純損(益)	(13)	(104)	(155)	(273)	(334)
本期淨利(淨損)	3,468	3,644	5,460	11,086	13,468
稀釋每股盈餘(元)	0.52	0.54	0.81	1.63	2.01

半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	53
個人電腦	14
汽車及消費性電子產品	32
其他	1
前十大客戶佔營收比重	47

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	56
歐洲	11
台灣	19
日本	7
亞洲其他地區	7

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced substrate & leadframe based	82
Traditional leadframe based	9
Module assembly	5
Others	4
封裝資本支出金額	140 百萬美元
打線機台數	13,535 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	85
晶圓測試	13
前段測試	2
測試資本支出金額	44 百萬美元
測試機台數	2,536 台

電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	33
電腦產品	21
消費產品	20
工業產品	16
汽車電子產品	10
其他	0
前十大客戶佔營收比重	78
EMS 資本支出金額	8 百萬美元